



2023 5th International Conference on Circuits and Systems

October 27-30, 2023, Huzhou, China

ICCS2023 will take place in Huzhou, China during October 27-30, 2023. ICCS 2023 is sponsored by University of Electronic Science and Technology of China and IEEE Chengdu CEDA, hosted by Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou.

COMMITTEES

CONFERENCE CHAIRS

Kai Kang, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou
Mohamad Sawan, Westlake University
Xinglai Ge, Southwest Jiaotong University

CONFERENCE CO-CHAIRS

Yuehang Xu, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou
Weixin Gai, Peking University
Weiqiang Liu, Nanjing University of Aeronautics and Aeronautics

PROGRAM CHAIRS

Letian Huang, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou
Xiaohang Wang, Zhejiang University
Wang Kang, Beihang University
Zhufei Chu, Ningbo University

PROGRAM CO-CHAIRS

Sheng Ma, National University of Defense Technology
Li Jiang, Shanghai Jiao Tong University
Esteban Tlelo-Cuautle, INAOE
Jayakumari J., Mar Baselios College of Engineering and Technology

TRACK CHAIRS

Maliang Liu, Xidian University
Gengen Liu, Fuzhou University
Jixin Zhang, Hubei University of Technology
Yibo Fan, Fudan University
Jing Jin, Shanghai Jiao Tong University
Zhao Zhang, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
Haoting Shen, Zhejiang University
Zhangyong Chen, University of Electronic Science and Technology of China
Guohua Zhou, Southwest Jiaotong University
Dandan Ding, Hangzhou Normal University
Yijiu Zhao, University of Electronic Science and Technology of China

LOCAL ORGANIZING CHAIRS

Kun Yang, Zhejiang University
Gang Li, Wenzhou University

TUTORIAL CHAIRS

Nan Qi, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Fei Gao, ShanghaiTech University

PUBLICATION CHAIR

Bo Zhao, Zhejiang University

PUBLICITY CHAIR

Yanlong Zhang, Xi'an Jiaotong University

FINANCE CHAIR

Biao Pan, Beihang University

SUBMISSION

Online submission system: <https://easychair.org/conferences/?conf=iccs20231>

E-mail submission: iccs@chairmen.org

Full paper template download: <http://www.iccs.org/files/conference-template-letter.docx>

Abstract template download: <http://www.iccs.org/files/A-template.doc>

Submission Deadline: May 10, 2023

PUBLICATION

Conference Proceedings

Accepted and registered full papers will be published by Conference Proceedings.



SCI/Scopus Journal

Selected papers after extension will be recommended to the following journals:

Journal of Electronic Science and Technology (ISSN: 1674-862X)
Citescore Track: 2.7
Indexing: Scopus, EI Compendex, INSPEC, CSCD, DOAJ etc.

ICCS History

ICCS 2022 | IEEE Conference Proceedings (EI Compendex & Scopus index)
ISBN: 978-1-6654-6036-1

IEEE Xplore : <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9935818/proceeding>

ICCS 2021 | IEEE Conference Proceedings (EI Compendex & Scopus index)
ISBN: 978-1-6654-1233-9

IEEE Xplore : <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9697107/proceeding>

ICCS 2020 | IEEE Conference Proceedings (EI Compendex & Scopus index)
ISBN: 978-1-7281-9121-8

IEEE Xplore : <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9336581/proceeding>

ICCS 2017 | IEEE Conference Proceedings (EI Compendex & Scopus index)
ISBN: 978-1-5090-6480-9

IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8320243/proceeding>

Topics Interested

<http://www.iccs.org/cfp.html>

Track 1: Analog and RF Circuits Design

Chair: Maliang Liu, Xidian University, China

Track 2: VLSI Design & Electronic Design Automatic

Chair: Gengen Liu, Fuzhou University

Track 3: Circuits and Systems for Signal Processing

Chair: Jixin Zhang, Hubei University of Technology

Track 4: Circuits and Systems for Communication

Chair: Jing Jin, Shanghai Jiao Tong University

Chair: Zhao Zhang, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences

Track 5: Design for Test & Reliability

Chair: Haoting Shen, Zhejiang University

Track 6: Power Electronic Circuits

Chair: Zhangyong Chen, University of Electronic Science and Technology of China

Chair: Guohua Zhou, Southwest Jiaotong University

Track 7: Circuits and Systems for Artificial Intelligence

Chair: Dandan Ding, Hangzhou Normal University

Track 8: Circuits and Systems for Instrumentation and Measurement

Chair: Yijiu Zhao, University of Electronic Science and Technology of China

SPECIAL SESSION

<http://www.iccs.org/ss.html>

Chiplet-based Integrated Systems

- * Advanced Packaging Technology
- * Die-to-die Interface & Interconnect Technology
- * Inter-Die Communication Network
- * Chiplet-based Accelerator Design

Organizers:

Letian Huang, University of Electronic Science and Technology of China
Xiaohang Wang, Zhejiang University

Sponsored by



Hosted by



Patrons



Ms. Maggie X. Xu
E-mail: iccs@chairmen.org



2023年第五届 电路与系统国际会议

2023年10月27-30日, 中国, 湖州

ICCS 2023

www.iccs.org

2023年第五届电路与系统国际会议将于2023年10月27-30日在湖州召开。

欢迎广大从事电路与系统理论及其应用教学、科研人员和学生踊跃投稿。

组 委 会

- 大会主席**
康凯, 电子科技大学长三角研究院 (湖州)
Mohamad Sawan, 西湖大学 (IEEE会士、加拿大工程院院士、工程研究院院士)
葛兴来, 西南交通大学
- 大会联合主席**
徐跃行, 电子科技大学长三角研究院 (湖州)
盖伟新, 北京大学
刘伟强, 南京航空航天大学
- 程序委员会主席**
黄乐天, 电子科技大学长三角研究院 (湖州)
王小航, 浙江大学
康旺, 北京航空航天大学
储著飞, 宁波大学
- 程序委员会联合主席**
马胜, 国防科技大学
蒋力, 上海交通大学
Esteban Tlelo-Cuautle, INAOE
Jayakumari J., Mar Baselios工程技术学院
- 分会主席**
刘马良, 西安电子科技大学
刘耿耿, 福州大学
张吉昕, 湖北工业大学
范益波, 复旦大学
金晶, 上海交通大学
张钊, 中国科学院半导体研究所
沈浩颀, 浙江大学
陈章勇, 电子科技大学
周国华, 西南交通大学
丁丹丹, 杭州师范大学
赵贻玖, 电子科技大学
- 本地组织委员会**
杨坤, 浙江大学
李刚, 温州大学
- 讲座主席**
祁楠, 中国科学院半导体研究所
高飞, 上海科技大学
- 出版主席**
赵博, 浙江大学
- 宣传主席**
张岩龙, 西安交通大学
- 财务主席**
潘彪, 北京航空航天大学

会议出版

会议论文集

接受并注册的全文将出版到会议论文集



会议特刊

优秀论文扩展之后, 将推荐至以下期刊:

Journal of Electronic Science and Technology (ISSN: 1674-862X)

Citescore Track: 2.7

检索: EI核心, Scopus, INSPEC, CSCD, DOAJ 等

会议历史

ICCS 2022 | IEEE 会议论文集 (已成功EI核心和Scopus检索) ISBN: 978-1-6654-6036-1

IEEE Xplore 上线: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9935818/proceeding>

ICCS 2021 | IEEE 会议论文集 (已成功EI核心和Scopus检索) ISBN: 978-1-6654-1233-9

IEEE Xplore 上线: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9697107/proceeding>

ICCS 2020 | IEEE 会议论文集 (已成功EI核心和Scopus检索) ISBN: 978-1-7281-9121-8

IEEE Xplore 上线: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9336581/proceeding>

ICCS 2017 | IEEE 会议论文集 (已成功EI核心和Scopus检索) ISBN: 978-1-5090-6480-9

IEEE Xplore 上线: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8320243/proceeding>

征稿主题

更多详情请访问: <http://www.iccs.org/cfp.html>

专题一: 模拟与射频电路设计

组织者: 刘马良, 西安电子科技大学

专题二: 大规模集成电路设计与电子设计自动化

组织者: 刘耿耿, 福州大学 张吉昕, 湖北工业大学

专题三: 面向信号处理的电路与系统

组织者: 范益波, 复旦大学

专题四: 面向通信的电路与系统

组织者: 金晶, 上海交通大学 张钊, 中国科学院半导体研究所

专题五: 可测性设计与可靠性设计

组织者: 沈浩颀, 浙江大学

专题六: 电力电子电路

组织者: 陈章勇, 电子科技大学 周国华, 西南交通大学

专题七: 面向人工智能的电路与系统

组织者: 丁丹丹, 杭州师范大学

专题八: 用于仪器和测量的电路与系统

组织者: 赵贻玖, 电子科技大学

专题研讨

更多详情请访问: <http://www.iccs.org/ss.html>

基于芯粒的集成系统

- 高级封装技术
- 裸片间接口与互连技术
- 裸片间互连网络
- 基于芯粒的加速器设计

组织者: 黄乐天, 电子科技大学 王小航, 浙江大学

投稿指南

在线投稿: <https://easychair.org/conferences/?conf=iccs20231>

邮箱投稿: iccs@chairmen.org

全文模板下载: <http://www.iccs.org/files/conference-template-letter.docx>

摘要模板下载: <http://www.iccs.org/files/A-template.doc>

投稿截止: 2023年5月10日

Sponsored by



Hosted by



Patrons



许老师

邮箱: iccs@chairmen.org